NIKAPLEX

ガラスコンポジット (CEM-3)

Glass composite (CEM-3)

L-6524C2 L-6524C1

(両面板) W - Sided Copper Clad Laminates (片面板)

[UV遮蔽タイプ:L-6524C2 UV] W - sided Copper Clad Laminates of UV shielding type:L-6524C2 UV

S - Sided Copper Clad Laminates

ガラス布 • ガラス不織布基材エポキシ樹脂銅張積層板(CEM-3) Glass fabric, glass non-woven fabric base epoxy resin copper-clad laminates (CEM-3)

■特長 Characteristic

●放熱性に優れています(熱伝導率 0.9 W/(m · K))。 Heat dissipation is excellent. Thermal conductivity 0.9 W/(m \cdot K).

●パンチング加工が可能です。 Punching work is available.

For amusement components

■用途 Use applications ●アミューズメント機器 ●LED照明機器、他 ●自動車用電子機器

For LED lighting equipment, others For automotive components

●産業機器用電子機器 For industrial equipment

■仕様 Specification

●両面板、片面板 Copper clad laminates

品番 Products	定尺寸法 (縱×横) Standard size (Lw × Cw)	銅箔厚さ Copper foil thickness	公称板厚 Nominal thickness	厚さ許容差 Thickness tolerance 両面板、片面板 W / S - sided CCL
L-6524C2 L-6524C1	$1,020 \stackrel{+10}{_{-0}} \times 1,020 \stackrel{+10}{_{-0}} mm$ $1,020 \stackrel{+10}{_{-0}} \times 1,220 \stackrel{+10}{_{-0}} mm$	18 μ m 35 μ m 70 μ m	0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm	±0.17 ±0.18 ±0.19 ±0.19

試験	項目	処理条件	単位	実測値	
Ite	Treatment	Unit	Actual value		
ガラス転移温度(Tg)	TMA		昇温:10℃/min Heating rate:10℃/min	°C	130
Glass transition temp	DSC		昇温:20°C/min Heating rate:20℃/min	°C	130
	X(横)	α1		ppm/°C	18
熱膨張係数	Y(縦)	α1 ΤΜΛ	TMA -	ppm/°C	21
Coefficient of thermal expantion	z –	α1		ppm/°C	60
		α2		ppm/°C	310
熱分解温度(Td) Decomposition temp			昇温:20°C/min Heating rate:20°C/min	°C	380
熱伝導率 Thermal conductivity	LF法 Laser flash method		A	W/(m •K)	0.9
比熱容量 Specific heat capacity	LF法 Laser flash method		A	J/(g •K)	1.2
はんだ耐熱性 260℃	Solder heat resistance at 260°C		A	秒 sec.	≧120
T ₂₈₈ Time to delamination	TMA	4	TMA	分 min	20
	18 μ m		A	N/mm	1.5
銅箔引き剥がし強さ			S₄		1.5
Peel strength	35 μ m		A		1.9
			S ₄		1.9
曲げ強さ Flexural strength	縦 Lw / 横 Cw		A	MPa	380 / 290
曲げ弾性率 Flexural modulus	縦 Lw /	横 Cw	Α	GPa	14 / 12
比誘電率	1MHz 1GHz		C-96/20/65	-	4.8
Dielectric constant (Dk)				_	4.3
誘電正接	1MHz 1GHz		C-96/20/65	-	0.020
Disspation factor (Df)				_	0.022
体積抵抗率	Volume resistivity		C-96/20/65	MΩ •m	1 × 10 ⁸
表面抵抗	Surface resistance		C-96/20/65	МΩ	1 × 10 ⁹
絶縁抵抗	Insulation resistance		C-96/20/65	МΩ	1 × 10 ⁹
比較トラッキング指数(CTI値)	Comparative tracking index (CTI)		A	V	175
吸水率	Water absorption		E-24/50 + D-24/23	%	0.04
耐アルカリ性(3%NaOH溶液)	Alkali resistance(3% NaoH aq)		40°C/3min 浸漬 Dip	_	異常なし No remarkable char
UV透過率(UV遮蔽タイプ)	UV-35		A	%	0.02
UV transmittance of UV shieldeing type	UV-42		A	%	2.01

L * 1 上記試験はJIS C 6481、IPC TM650、IEC-60112、UL規格に準じます。

^{*1} The abobe tests are in accordance with JIS C6481, IPC TM650, IEC-60112, and UL.

^{*2} 試験板厚は1.6mmです。 *3 上記は実測値であり、保証値ではございません。

^{*2} The sample thickness is 1.6mm. *3 The abobe data is actual values and not guaranteed values.